



北京ワールドダイヤ

PCDマイクロドリル WZシリーズ

標準で直径0.2mmから対応



京二
執行役員

俞 箴潔氏

シリコンや炭化ケイ素 (SiC) などの半導体材料の他、ガラスやグラファイトといった硬ぜい材に穴を開けるために使われるのが、PCD (多結晶ダイヤモンド焼結体) マイクロドリルです。WZシリーズの最新製品「WZ-X」はSiCの加工にも対応し、最も細いものは直径0.2mmからラインアップします。マイクロドリルの領域では中国でも大手に入るメーカーで、特注で0.1mm台にも対応する製造技術が強みです。

ドリル先端の黒い部分がPCDのソリッド刃で、高硬度と耐摩耗、長寿命を実現しました。超硬のネックにろう付けされていますが、非常に細いドリルなので、変形させることなく精密に接合するのは難しく、量産を実現した点に技術の高さが表れています。

刃面はラッピング仕上げで、加工穴の位置や直径の精度が高く、フルートも独自の研磨技術で仕上げられています。シリーズ製品の「WZ3」でシリコンを加工した事例では、穴の内面はRa (算術平均粗さ) = 0.094 μ mと非常に滑らかでした。

メーカー在庫がしっかりと確保されており、仕上げの研磨をして速やかに出荷されます。昨今の円安の状況下でも引き続き価格面で魅力があり、加工品質や耐久性を含め、お客さまに好評をいただいている製品です。



特徴

先端にPCDのソリッド刃をろう付けしたマイクロドリル。半導体や航空機分野の小径穴開けで需要の高いサイズを中心に広くラインアップする。グラファイトやアルミ向けの「WZ1」、セラミックや耐摩耗素材向けの「WZ2」、シリコン向けの「WZ3」に加え、昨年10月にはSiCの加工に対応する新製品「WZ-X」を日本でも発売した。

問い合わせ先

株式会社京二

〒102-0073

東京都千代田区九段北4-3-24

TEL 03-3264-5240

